

株主の皆さまへ

第45期報告書

2022年4月1日から2023年3月31日まで



株主の皆さまへ

ご挨拶

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ここに、当社第45期報告書（2022年4月1日から2023年3月31日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当連結会計年度における世界経済は、各国でウィズコロナに向けた行動制限の解除により、持ち直しの傾向が見られたものの、長引くロシア・ウクライナ危機の影響によるエネルギー価格の高騰や世界的な物価高とインフレ抑制に向けた欧米での金利上昇により、回復ペースが鈍化するなど、先行き不透明な状況が続きました。

半導体業界につきましては、パソコンやスマートフォンの需要減少からメモリ半導体は在庫調整が行われ、設備投資計画についても抑制が続きました。一方、車載用半導体や省エネルギー化に貢献するパワー半導体については、堅調な需要が継続しました。

このような状況のもと、当社グループは車載用半導体やパワー半導体の需要の高まりや、地政学的リスクの観点から半導体関連の設備投資が続く東南アジア地域において、2023年4月6日にK-Tool Engineering Sdn. Bhd.の金型製造事業を譲り受けました。東南アジアの既存拠点との連携により、半導体製造用装置と金型の設計・製造・販売の一貫体制を構築し、プロセスビジネスの展開や半導体メーカー各社とのより強固な関係構築を目指してまいります。

今後とも、株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、グループ一丸となって邁進していく所存でございますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長 **岡田博和**

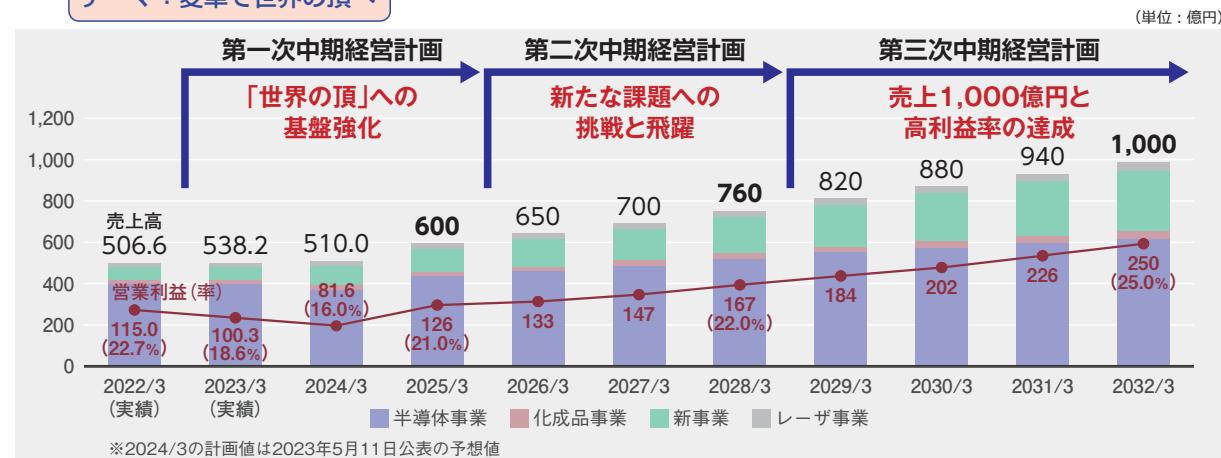
2023年6月

第45期の概況と今後の計画

業績につきましては、前期から積み上げた高水準の受注残高を着実に生産・売上につなげた結果、売上高は前期に続き、過去最高となりました。利益につきましては、パワー半導体やEV向けなどの付加価値の高いトランスファ装置の販売台数が増加したことにより、販売単価の上昇やトランスファ装置における製品ミックスは改善したものの、期初から大幅な円安が続き、海外子会社での生産コスト等が円換算時に膨らんだこと、また、「TOWAビジョン2032」達成に向けた人員強化や、先端パッケージ向けモールド装置の開発などを積極的に進めたことなどから販売管理費が増加し、各段階利益ともに前期比で減益となりました。

TOWAビジョン2032の概要

テーマ：変革で世界の頂へ



第一次中期経営計画（2023年3月期～2025年3月期）の概要

テーマ：TOWAが創り出すプロセスイノベーション

(単位：億円)

	2023年3月期			2024年3月期		2025年3月期
	当初計画	2023/2/7修正	実績	当初計画	2023/5/11公表	計画
売上高	550	550.0	538.2	570	510.0	600
半導体事業	420	425.9	412.7	425	370.6	440
化成事業	19	18.2	19.5	20	20.0	22
新事業	86	79.4	80.1	100	93.4	112
レーザ事業	25	26.5	25.9	25	26.0	26
営業利益	122	103.0	100.3	124	81.6	126
営業利益率	22.2%	18.7%	18.6%	21.8%	16.0%	21.0%
経常利益	122	103.0	102.0	124	81.6	126
当期純利益(※)	85	72.0	73.4	87	57.1	88

※ 当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益

事業の拡大 マレーシアにおける金型製造事業譲受及び製造子会社の設立

半導体製造装置事業と金型製造事業の連携による更なる事業発展・拡大のため、今般、K-Tool Engineering Sdn. Bhd. (以下、K-Tool社) の金型製造事業を譲り受けることとし、合わせてその受け皿となる製造子会社を設立しました。

K-Tool社の金型製造事業部門は半導体製造用金型の専門技術者を有し、高精度な金型メーカーとして国内外の企業から認められております。高い技術力を持つ同社の従業員と既存顧客を当社が引き継ぐことで、東南アジア地域での金型事業の早期立ち上げが可能となります。

近年、世界的に脱炭素化が進む中、EV用車載半導体や省エネルギー半導体の需要が高まり、これらの製品を生産するための設備投資が東南アジア地域で加速しております。更に、地政学的リスクの観点からも東南アジア地域への関心が高まり、半導体メーカー各社の積極的な投資が今後も続くことが予想されます。

かかる状況下、当社グループは、マレーシア、シンガポール、フィリピン、タイに展開している既存拠点との連携により、半導体製造用装置と金型の設計・製造・販売の一貫体制を構築することでプロセスビジネスの展開を図ってまいります。



取引機会の拡大 SEMICON JAPAN 2022に出展

2022年12月14日～16日に東京ビッグサイトで開催された「SEMICON JAPAN 2022」に出展しました。当社は同時開催である後工程技術に特化した「Advanced Packaging and Chiplet Summit」にも参画し、最先端パッケージングへの最適なモールドング技術のほか、シミュレーション技術・レーザ技術・ものづくりサポート体制・TSS(トータルソリューションサービス)などの取り組みについて展示紹介を行いました。

総来訪者数は374名と前年を大きく上回る結果となり、更なる受注に繋がるきっかけを得られた大変意義のある出展となりました。引き続き積極的な営業活動を行ってまいります。



人的資本経営への取り組み

健康経営優良法人2023認定

経済産業省と日本健康会議が実施する健康経営優良法人認定制度において、昨年に引き続き「健康経営優良法人2023(大規模法人部門)」に認定されました。

当社では、健康経営の一環として、社員が喜びとやりがいを抱いて仕事に取り組める環境づくりに取り組んでおります。今後も社員一人ひとりの健康維持・増進、ワーク・ライフ・バランスの向上に取り組み、健康経営を推進してまいります。



ヘルスケアルームを設置

社員の健康推進と福利厚生を目的としてヘルスキーパー(企業内理療師)を設置しました。

理療の国家資格を持ったヘルスキーパーが理療の施術やセルフケア指導、健康への助言などを行っております。

また、ヘルスケアルームの使用に関しては、業務時間中無料で利用できるようにしており、社員が利用しやすい環境整備にも力を入れております。



コーポレート・ガバナンスの強化

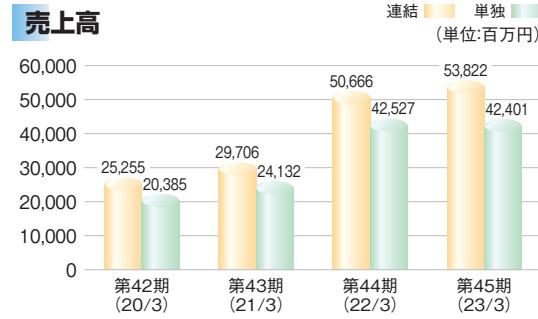
当社は、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、継続的にコーポレート・ガバナンス体制の充実を図っております。

取締役会の機能強化と多様性を高める目的から2022年6月より、女性役員を1名増員し2名といたしました。これにより女性役員比率は22%となりました。

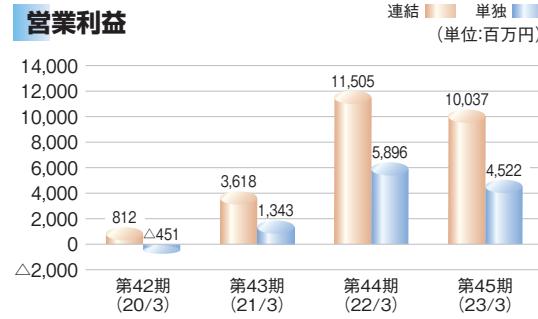
引き続き、企業価値向上に向け様々な取り組みを積極的に行ってまいります。

業績の推移

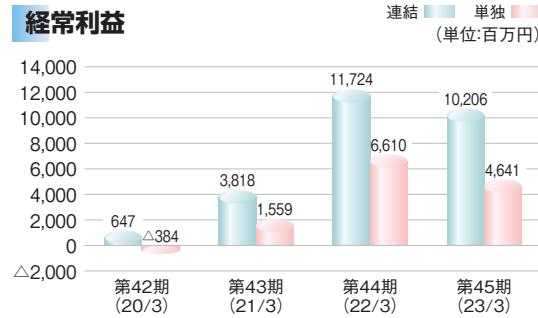
売上高



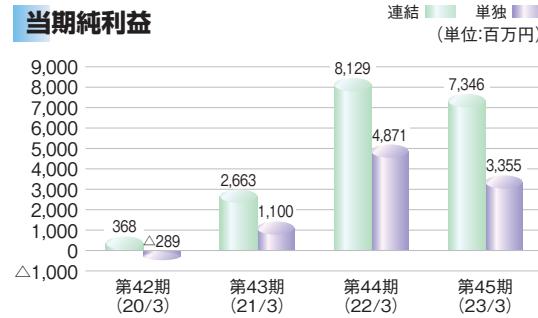
営業利益



経常利益

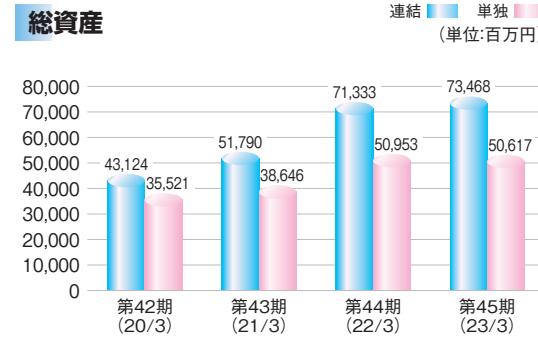


当期純利益

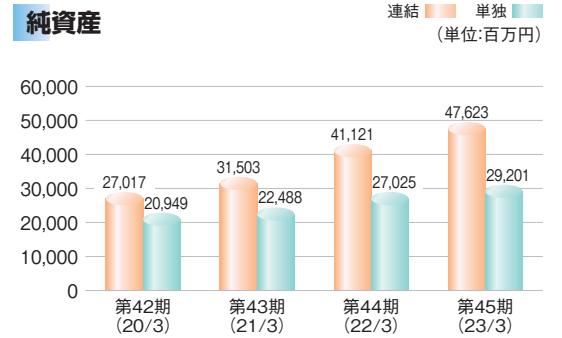


(注)連結については、親会社株主に帰属する当期純利益を記載しております。

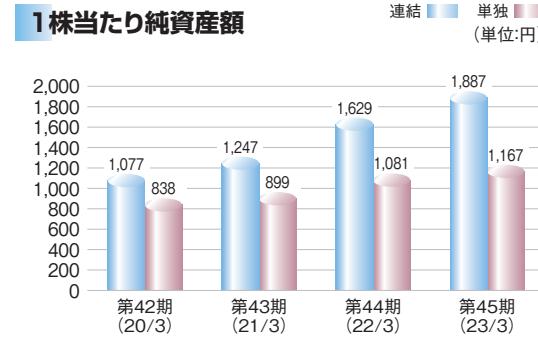
総資産



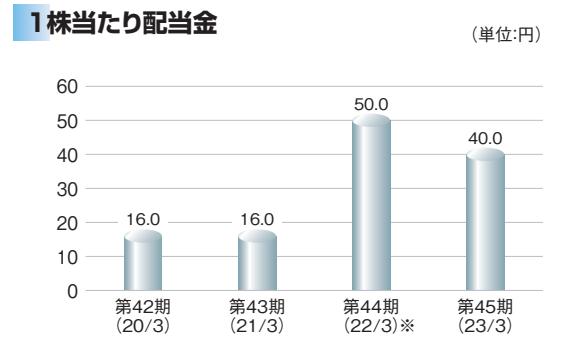
純資産



1株当たり純資産額



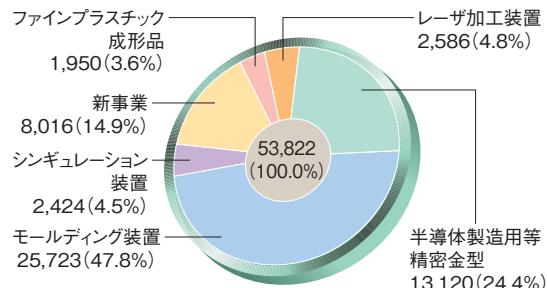
1株当たり配当金



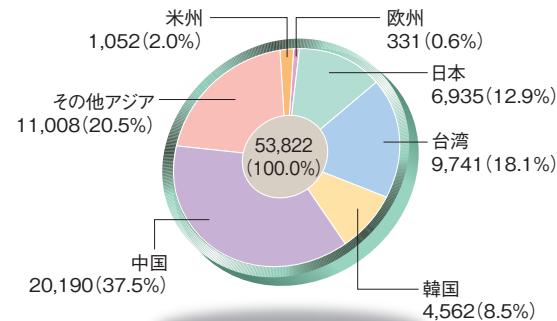
※第44期(22/3)配当金の内訳 普通配当40円 記念配当10円

[セグメント別連結売上高(第45期)]

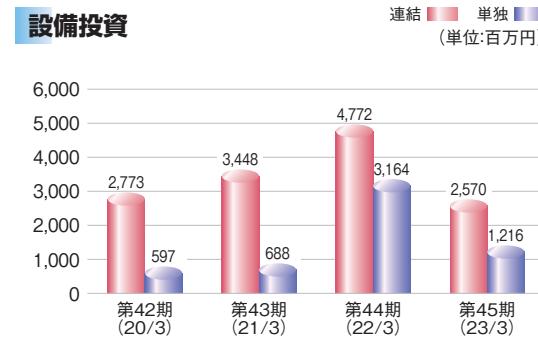
製品別 (単位:百万円)



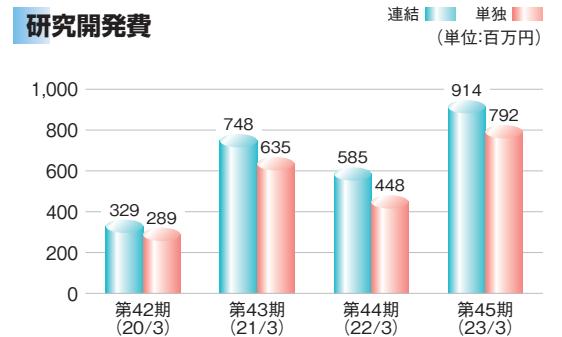
地域別 (単位:百万円)



設備投資



研究開発費



決算概要

連結貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位: 百万円)

科目	金額
【資産の部】	
流動資産	45,960
現金及び預金	16,547
受取手形及び売掛金	11,766
電子記録債権	1,201
棚卸資産	15,407
その他	1,037
固定資産	27,508
有形固定資産	21,359
建物及び構築物	8,691
土地	5,205
その他	7,462
無形固定資産	1,162
投資その他の資産	4,986
資産合計	73,468

(注) 当期の連結子会社は 18社であります。

連結損益計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位: 百万円)

科目	金額
売上高	53,822
売上原価	35,014
売上総利益	18,808
販売費及び一般管理費	8,771
営業利益	10,037
営業外収益	349
営業外費用	180
経常利益	10,206
特別利益	0
特別損失	23
税金等調整前当期純利益	10,183
法人税・住民税及び事業税	2,314
法人税等調整額	516
当期純利益	7,352
非支配株主に帰属する当期純利益	5
親会社株主に帰属する当期純利益	7,346

科目	金額
【負債及び純資産の部】	
流動負債	19,747
支払手形及び買掛金	2,411
電子記録債務	46
短期借入金	9,400
一年以内返済予定長期借入金	1,930
前受金	1,882
その他	4,077
固定負債	6,097
長期借入金	3,950
その他	2,147
負債合計	25,845
株主資本	42,318
資本金	8,942
資本剰余金	472
利益剰余金	32,916
自己株式	△ 13
その他の包括利益累計額	4,903
その他の有価証券評価差額金	2,312
為替換算調整勘定	2,570
退職給付に係る調整累計額	20
非支配株主持分	401
純資産合計	47,623
負債・純資産合計	73,468

連結キャッシュ・フロー計算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位: 百万円)

科目	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,831
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,746
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,962
現金及び現金同等物の期末残高	16,430

連結株主資本等変動計算書 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位: 百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2022年4月1日 期首残高	8,932	462	26,820	△ 12	36,202
連結会計年度中の変動額					
新株の発行	10	10			20
剰余金の配当			△ 1,250		△ 1,250
親会社株主に帰属する当期純利益			7,346		7,346
自己株式の取得				△ 0	△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	10	10	6,096	△ 0	6,116
2023年3月31日 期末残高	8,942	472	32,916	△ 13	42,318

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他の有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
2022年4月1日 期首残高	2,261	2,169	94	4,526	392	41,121
連結会計年度中の変動額						
新株の発行						20
剰余金の配当						△ 1,250
親会社株主に帰属する当期純利益						7,346
自己株式の取得						△ 0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	50	400	△ 74	376	8	385
連結会計年度中の変動額合計	50	400	△ 74	376	8	6,501
2023年3月31日 期末残高	2,312	2,570	20	4,903	401	47,623

会社の概要

商号	TOWA株式会社 (英文名TOWA CORPORATION)		
設立	1979年4月17日		
資本金	8,942,950,207円		
本社所在地	京都市南区上烏羽上調子町5番地 ☎(075) 692-0250 (代表)		
従業員数	597名 (単体)	1,876名 (連結)	
役員	代表取締役社長	岡田博和	
(2023年6月29日現在)	取締役常務執行役員	石田耕一	
	取締役上席執行役員	柴原信隆	
	取締役執行役員	西村一洋	
	取締役執行役員	三浦宗男	
	取締役常勤監査等委員	浦生喜代重	
	社外取締役監査等委員	和氣大輔	
	社外取締役監査等委員	後藤美穂	
	社外取締役監査等委員	田中美子	
	上席執行役員	早坂昇	
	上席執行役員	鈕方舜	
	上席執行役員	韓相倫	
	執行役員	笹田秀典	
	執行役員	中西和彦	
ホームページ	https://www.towajapan.co.jp		
上場取引所	東京証券取引所プライム市場		

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日までの1年		
定時株主総会	毎年6月		
基準日	株主総会権利行使及び期末配当	3月31日	
	中間配当	9月30日	
単元株式数	100株		
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社		
同事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社本店証券代行部		
郵便物の郵送先及び 電話お問い合わせ先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社証券代行部 ☎0120-288-324 (フリーダイヤル)		
株主総会資料の電子提供制度(書面文 付請求)についてのお問い合わせ先	みずほ信託銀行株式会社証券代行部 ☎0120-524-324 (電子提供制度専用フリーダイヤル)		
未払い配当金のお支払	みずほ信託銀行 本店及び全国各支店 みずほ銀行 本店及び全国各支店		
公告方法	電子公告の方法により行います。但し、 やむを得ない事由により電子公告をす ることができない場合は、日本経済新聞 に掲載します。 公告掲載URL https://www.towajapan.co.jp		

株式の状況 (2023年3月31日現在)

●発行可能株式総数	80,000,000株
●発行済株式の総数	25,033,238株
●株主数	18,565名
●大株主	

株主名	持株数	持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	2,923 千株	11.68 %
株式会社日本カストディ銀行	2,195	8.77
株式会社ケイビー恒産	2,000	7.99
株式会社エヌレガロ	1,400	5.60
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE : UCITS CLIENTS 15. 315 PCT NON TREATY ACCOUNT	721	2.88
株式会社京都銀行	699	2.80
KIA FUND136	488	1.95
TOWA社員持株会	378	1.51
GOVERNMENT OF NORWAY	361	1.44
京都中央信用金庫	300	1.20

(注1) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び株式会社日本カストディ銀行の持株数は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式 (13,597株) を控除して計算しております。

TOWAグループ (2023年3月31日現在)

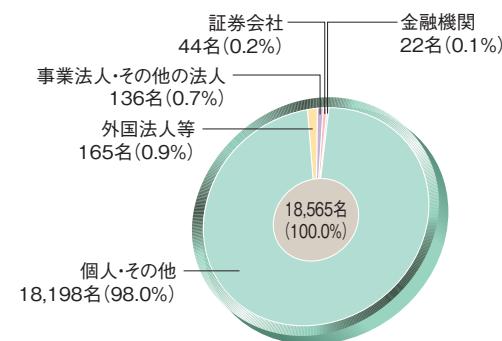
■国内

TOWA株式会社
本社・工場
京都東事業所
九州事業所
株式会社バンディック
TOWATEC株式会社
TOWAレーザーフロント株式会社

■海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)
TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)
TOWA TOOL Sdn. Bhd. (マレーシア)
TOWA Semiconductor Equipment
Philippines Corp. (フィリピン)
TOWA THAI COMPANY LIMITED (タイ)
TOWA USA Corporation (米国)
TOWA Europe B.V. (オランダ)
TOWA Europe GmbH (ドイツ)
TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)
東和半導体設備(上海)有限公司 (中国)
東和半導体設備(南通)有限公司 (中国)
東和半導体設備研究開発(蘇州)有限公司 (中国)
台湾東和半導体設備股份有限公司 (台湾)
TOWA韓国株式会社 (韓国)
TOWAファイン株式会社 (韓国)

■所有者別株主数分布



■所有者別株式数分布

